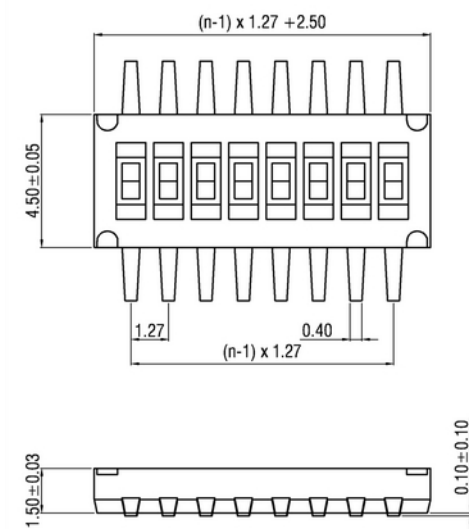
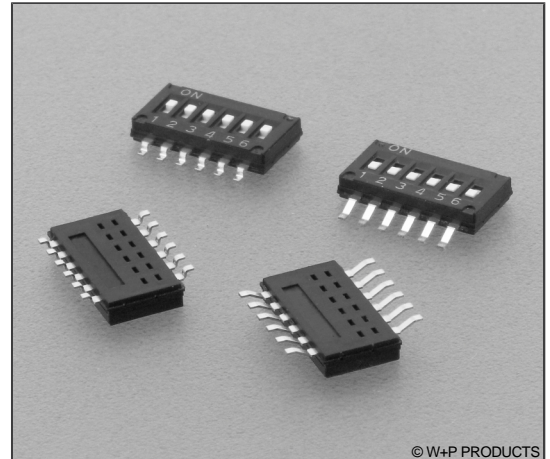
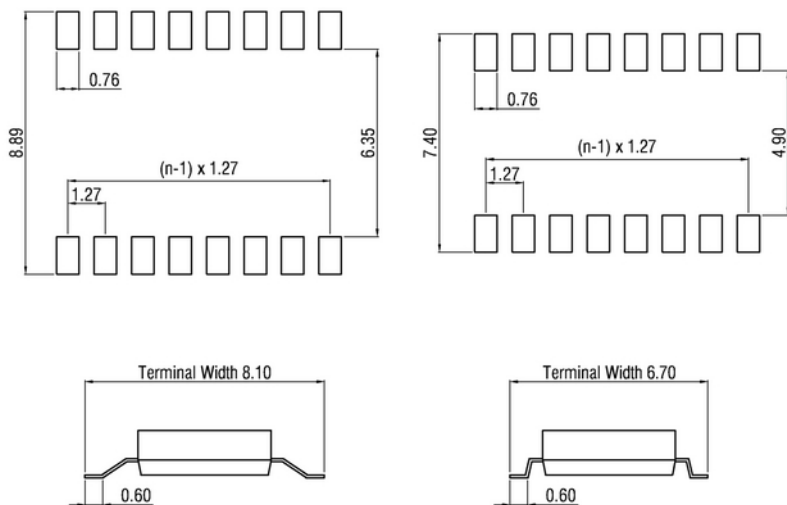


Technische Daten / Technical Data

Gehäuse/Abdeckung/Hebel	HT Nylon/HT Nylon/HT LCP; UL94 V-0
Case/Cover/Actuator	HT Nylon/HT Nylon/HT LCP; UL94 V-0
Farbe	Gehäuse: Schwarz, Hebel: Weiß
Colour	Black housing, white actuators
Kontaktmaterial	Schaltkontakt: Kupferlegierung Lötkontakt: Messing
Contact Material	Switch: Copper Alloy Terminal: Brass
Kontaktbelastbarkeit	50V _{DC} , 100mA in Ruhe 24V _{DC} , 25mA im Schaltvorgang
Contact Rating	50V _{DC} , 100mA in steady situation 24V _{DC} , 25mA at mate and break
Kontaktoberfläche	Vergoldet
Contact Surface	Gold plated
Durchgangswiderstand	< 100 mΩ at initial state
Contact Resistance	< 100 mΩ at initial state
Isolationswiderstand	> 100 MΩ
Insulation Resistance	> 100 MΩ
Spannungsfestigkeit	300 V AC
Test Voltage	300 V AC
Temperaturbereich	-40 °C ... +85 °C
Temperature Range	-40 °C ... +85 °C
Elektrische Lebensdauer	> 1000 Zyklen/Schalter
Electrical Life	> 1000 cycles/switch
Mechanische Lebensdauer	> 1000 Zyklen/Schalter
Mechanical Life	> 1000 cycles/switch
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering



Recommended PCB Layouts



Series	Terminal Width*	Circuits*	Switch Position*	Packaging*
5046	2 1 6.70mm 2 8.10mm	08 02 04 06 08 10	2 2 OFF (Standard) 1 ON	FST ST TR FST FTR

Lieferformen / Packaging Options:

- ST In Stangen / In tubes
- TR Tape & Reel (Option) / Tape & Reel (Option)
- FST In Stangen, mit Abdeckfolie / In tubes, top film tape sealed
- FTR Tape & Reel, mit Abdeckfolie (Option) / Tape & Reel, top film tape (Option)

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an **order example** - please replace by your specifications.

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Lötten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	217 °C
Duration above T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

